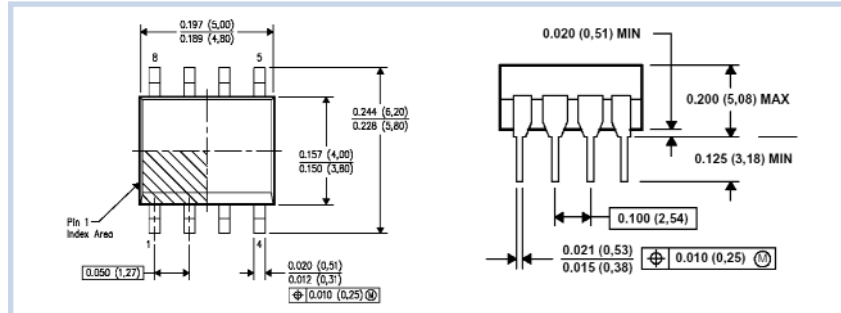


Streifenlochrasterplatine für SO-Gehäuse modifizieren

Von Dirk Gehrke

Die hier beschriebene Lösung zur Modifizierung von Standard-Streifenlochrasterplatten zur Aufnahme von SO-IC-Gehäusen ist für den preisgünstigen und schnellen Laboraufbau gedacht. Damit steht auch eine preisgünstige Alternative zu Spezialplatten zur Verfügung, die ein SO-Gehäuse aufnehmen und den Pinabstand von 1,27 mm auf 2,54 mm Rasterabstand verbreitern. In **Bild 1** sind die Standardabmessungen eines SO-Gehäuses und eines Plastik-DIP-Gehäuses gegenübergestellt (Angaben in mm sind in Klammern gesetzt).

Das Rastermaß einer Streifenlochrasterplatine beträgt 2,54 mm. Diese Streifenlochrasterplatten aus Epoxyd oder Hartpapier können in verschiedenen Größen bezogen werden. Standardmäßig werden sie im Europakartenformat mit 100 mm x 160 mm vertrieben. Um nun ein IC im SO-Gehäuse auf die Streifenlochrasterplatine löten zu können, wird mit einem Cuttermesser die Verbindung zwischen den Löchern in der Mitte aufgetrennt, so dass der Rasterabstand von zuvor 2,54 mm auf 1,27 mm verkleinert wird. Die nun so vorbereitete Platine kann nun SO-Gehäuse aufnehmen. **Bild 2** zeigt eine skizzierte Anwendung mit einem TL5001 im SO-Gehäuse, wobei die grünen Punkte und die grünen Linien



Unterbrechungen darstellen, die mit einem Leiterbahnunterbrecher und/oder

Cuttermesser angefertigt werden müssen.

(050119)e

